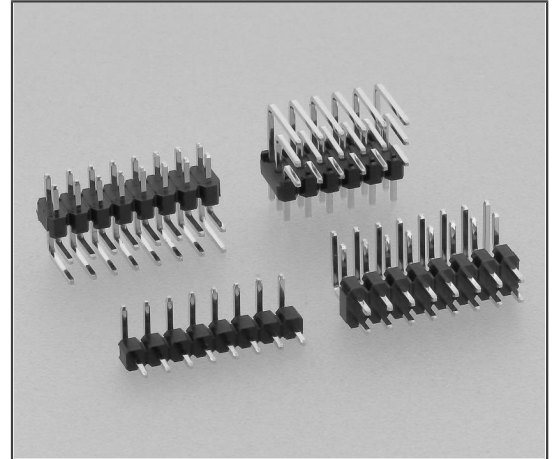
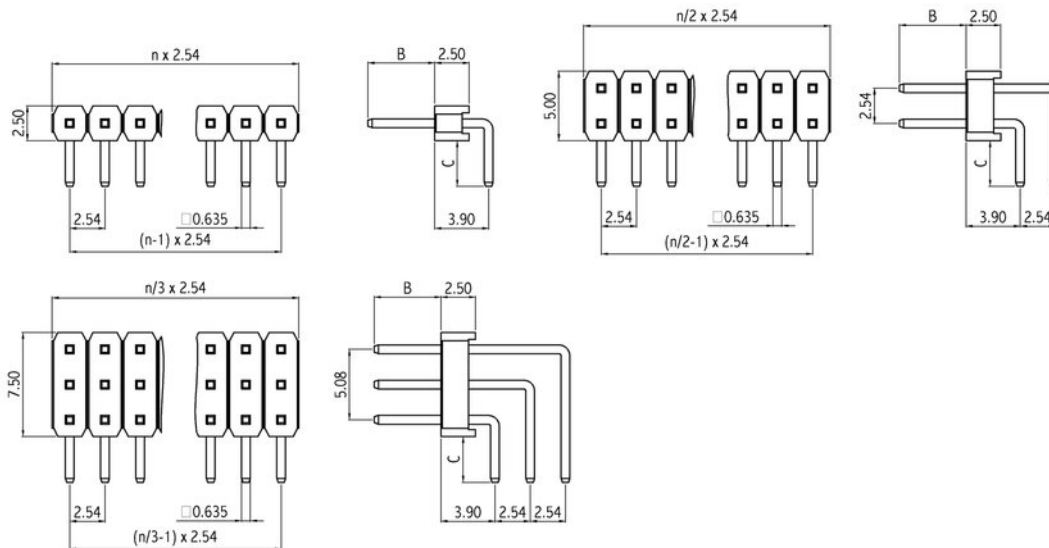


**Technische Daten / Technical Data**

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.635mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV DC
Test Voltage	1 kV DC
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	250 V AC
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +125 °C
Temperature Range	-40 °C ... +125 °C
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	Wave or reflow soldering



Passende  
 Buchsenleisten: *Compatible*  
 Female Headers:  
 TC-0306 / TC-0308 /  
 TC-0314157 / TC-0318159  
 etc.  
 Weitere siehe Kapitel  
 B Please see ch. B for  
 more



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12  
 Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.

Series*	Dimensions*	Contacts*	Plating*
<b>TC-18947</b>	<b>12</b>	<b>010</b>	<b>00</b>
<b>Gestanzte/geprägte Kontakte</b> Stamped/formed contacts	12 B=3,50 C=3,30mm	001-050 Einreihig Single row	00 Vergoldet Gold plated
<b>TC-18926</b> Einreihig Single row	13 B=4,80 C=3,30mm	004-100 Zweireihig Double row	110 Sel. Au 0,25µm / flash
<b>TC-18947</b> Zweireihig Double row	14 B=6,10 C=3,30mm	009-120 Dreireihig Triple row	130 Sel. Au 0,75µm / flash
	15 B=6,90 C=3,30mm		50 Verzinkt Tin plated
	16 B=9,90 C=3,30mm		66 Sel. Au / Sn
	17 B=12,00 C=3,30mm		610 Sel. Au 0,25µm / Sn
	18 B=13,80 C=3,30mm		80 Sel. Au 0,75µm / Sn
	19 B=15,00 C=3,30mm		<b>Au flash = min. 0,025µm</b>
	20 B=17,10 C=3,30mm		

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl.  
 Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster sowie  
 weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage.  
 Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter  
 Techn. Informationen.

We will manufacture the pin headers in every desired  
 number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying  
 pitches as well as more dimensions on request. Order  
 page "Customer-specific Pin Configurations" in Technical  
 Information.

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
 \* This is an **order example** -  
 please replace by your specifications.

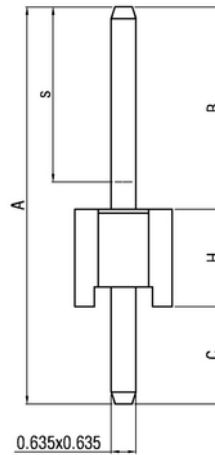
# Stiftleistenmaße und PCB Layouts für 0,635mm Vierkantstifte

## Dimensions and PCB Layouts

### Gerade Stiftleisten / Straight Pin Headers

- A : Gesamtstiftlänge / Overall Pin Length
- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

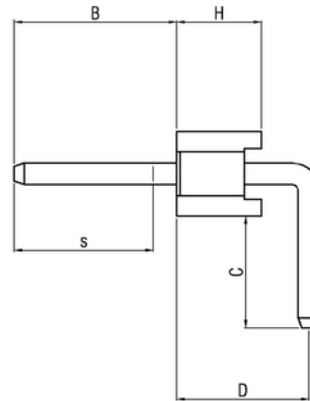
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



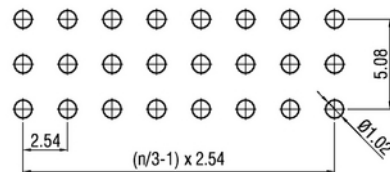
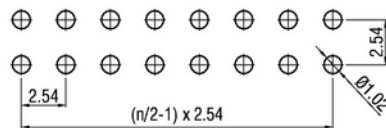
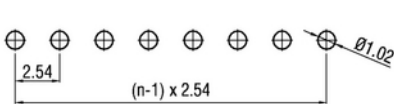
### Gewinkelte Stiftleisten / Right-Angled Pin Headers

- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze.  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip.



### PCB Layouts

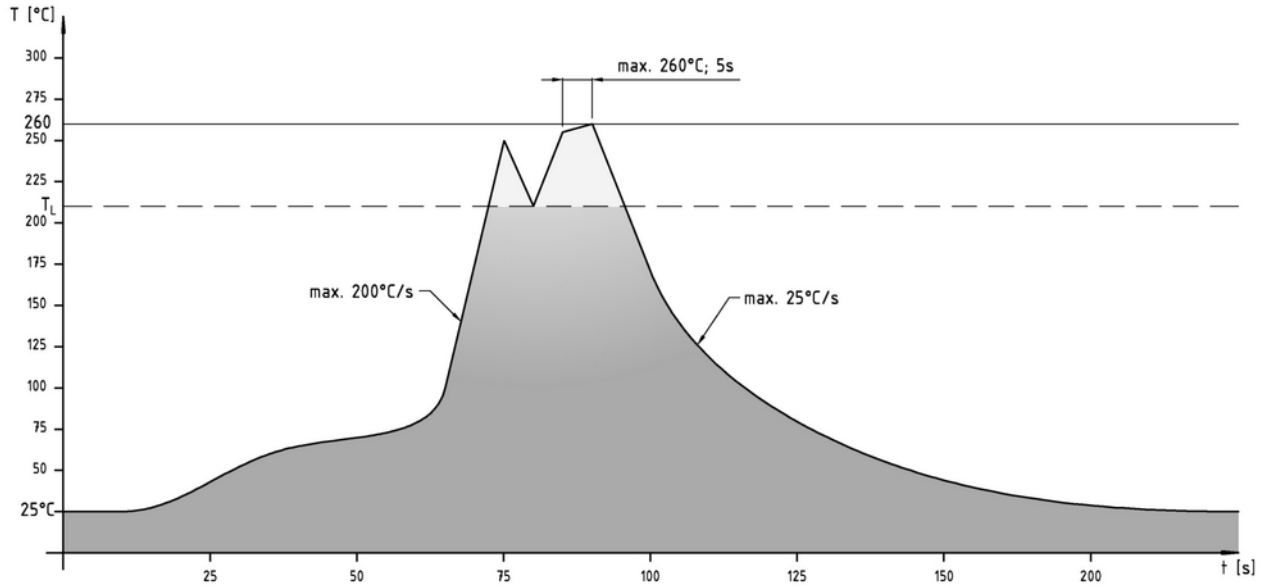


### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*



# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

